

基础化工

新材料周报：2024H1 OLED 手机出货量将同增 43%，日本 32 家电子元件制造商投资额将增长 5.4%

投资要点：

► **本周行情回顾。**本周，Wind 新材料指数收报 2773.31 点，环比下跌 0.19%。其中，涨幅前五的有国瓷材料(8.22%)、华特气体(7.07%)、安集科技(5.54%)、飞凯材料(4.95%)、光威复材(4.94%)；跌幅前五的有新亚强(-10.62%)、三祥新材(-8.33%)、瑞丰高材(-7.53%)、晨光新材(-7.51%)、阿科力(-7.33%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报 5154.99 点，环比上涨 0.9%；申万三级行业显示器件材料指数收报 932.97 点，环比下跌 5.84%；中信三级行业有机硅材料指数收报 5004.39 点，环比下跌 0.36%；中信三级行业碳纤维指数收报 918.51 点，环比下跌 2.01%；中信三级行业锂电指数收报 1483.68 点，环比下跌 1.36%；Wind 概念可降解塑料指数收报 1367.33 点，环比下跌 2.75%。

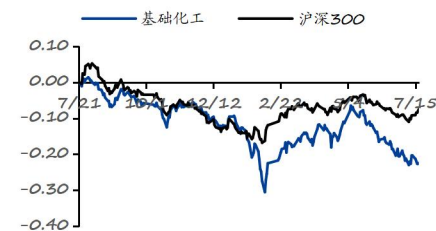
► **2024 年上半年 OLED 智能手机出货量将同比增长 43%。**7 月 18 日，Counterpoint Research 发文称，2024 年第一季度 OLED 智能手机出货量和营收较 2023 年同期分别增长了 50% 和 3%。预计 2024 年上半年，OLED 智能手机出货量将同比增长 43%，营收同比增长 7%。预计 2024 年全年，OLED 智能手机出货量将同比增长 21%，面板营收同比增长 3%。其中柔性 OLED 出货量同比增长 13%，折叠式 OLED 出货量同比增长 26%，刚性 OLED 出货量同比增长 46%。报告预计，OLED 智能手机在 2024 年的出货量增长将达到两位数。最新经济指标显示通胀环境正趋于稳定，并且有迹象表明，人工智能和三星、苹果等公司的新机型将强有力地推动该增长趋势，并形成一超级周期。（资料来源：OLEDindustry、IT 之家）

► **日本 32 家电子元件制造商投资额将增长 5.4%。**随着汽车从混合动力传动系统到高级驾驶辅助系统等各个领域继续采用更多的电气部件，日本的电子元件制造商本财年预计将资本支出提高 5.4%。根据村田制作所、TDK 和京瓷等 32 家公司的投资计划，预计 2024 财年总支出将达到 1.4 万亿日元(87 亿美元)，较 2023 年增长 5.4%，比四年前增长 46%。其中 19 家公司计划增加支出。电容器、线圈等被动元件是投资的重心，占比达 60%。2024 财年该领域的投资有望达到 8672 亿日元，延续 2023 财年的高水平。尤其是多层陶瓷电容器 (MLCC)，一般来说，智能手机中大约使用 1000 个 MLCC，燃油车中大约使用 5000 个，电动汽车中大约使用 10000 个。日本公司主导着这些零部件的全球市场。村田拥有汽车 MLCC 的最大份额，TDK 和太阳诱电也位列前五。随着韩国和中国台湾公司的崛起，日本公司希望通过保持资本投资来维持市场份额。村田 2024 财年计划投资 1900 亿日元，将汽车用 MLCC 产能提高 10%。TDK 总裁 Noboru Saito 表示：“电动汽车目前正处于调整阶段，但混合动力汽车和插电式汽车对 MLCC 的使用仍将增加。”该公司预计今年的资本投资将达到 2500 亿日元，比上年增长 14%。TDK 的投资将集中在电池上，其电池占销售额的一半，但约 25% 将分配给 MLCC 等被动元件。32 家公司对电动汽车和混合动力汽车的电机也进行了大力投资，投资总额达 1576 亿日元，较 2023 财年增长 14%。投资热潮还延伸到电子电路板。随着汽车电气化程度的提高，对密集排列半导体和零部件的电路板的需求也在增加。2024 财年日本电路板投资将达 2225 亿日元，增长 22%。除了汽车零部件外，电子元件制造商也在投资人工智能 (AI) 领域。太阳诱电今年计划投资 700 亿日元，其中大部分将投资 AI 服务器用 MLCC。该公司每年将产能提高 10%~15%，并将在中国和马来西亚的工厂设立生产线。京瓷今年计划投入 2000 亿日元资本支出，较上一财年增长 20%，为公司历史上最大单笔资本支出，该公司将投资用于数据中心的 AI 半导体先进封装的生产设施。（资料来源：满天芯）

► **重点标的：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。**光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域

强于大市（维持评级）

一年内行业相对大盘走势



团队成员

分析师：孙范彦卿(S0210524050021)
sfyq30569@hfzq.com.cn

相关报告



十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议关注**华特气体**。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：**安集科技、鼎龙股份**。**下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期**。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议关注新材料平台型公司**国瓷材料**。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头**利安隆**，珠海新基地产能逐步释放，凭借**康泰股份**，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议关注国内抗老化剂龙头**利安隆**。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业**合盛硅业、EVA** 粒子技术行业领先的**联泓新科**、拥有三氯氢硅产能的**新安股份**以及**三孚股份**。

➤ 风险提示

下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等



正文目录

1 整体市场行情回顾.....	4
2 重点关注公司周行情回顾.....	5
2.1 周涨跌幅前十.....	5
2.2 重要公告.....	6
3 近期行业热点跟踪.....	6
3.1 2024 年上半年 OLED 智能手机出货量将同比增长 43%.....	6
3.2 87 亿美元! 日本 32 家电子元件制造商投资额将增长 5.4%.....	7
3.3 Q2 全球智能手机出货量达 2.88 亿部, 小米增速居首.....	8
3.4 日系被动元件大厂计划涨价 20%!	8
3.5 预估 2024 年全球 AI 服务器产值达 1870 亿美元, 约占服务器市场比重 65% 9	
4 相关数据追踪.....	9
5 风险提示.....	11

图表目录

图表 1: Wind 概念新材料指数.....	4
图表 2: 申万行业半导体材料指数.....	4
图表 3: 申万行业显示器件指数.....	4
图表 4: 中信行业有机硅指数.....	5
图表 5: 中信行业碳纤维指数.....	5
图表 6: 中信行业锂电化学品指数.....	5
图表 7: Wind 概念可降解塑料指数.....	5
图表 8: 本周涨跌幅前十.....	5
图表 9: 本周涨跌幅后十.....	6
图表 10: 费城半导体指数.....	9
图表 11: 国产集成电路当月出口金额 (万美元)	10
图表 12: 国产集成电路当月进口金额 (万美元)	10
图表 13: NANDFlash 日度价格图 (美元)	10
图表 14: DRAMDDR3 日度价格图 (美元)	10



1 整体市场行情回顾

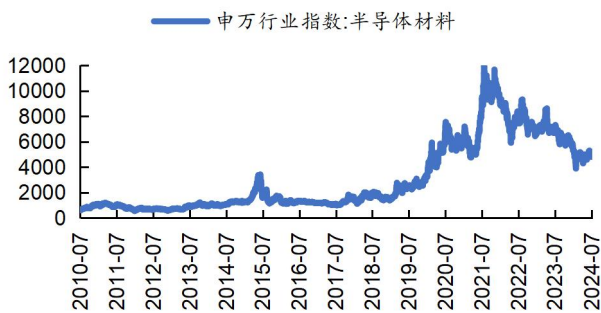
本周，Wind 新材料指数收报 2773.31 点，环比下跌 0.19%。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报 5154.99 点，环比上涨 0.9%；申万三级行业显示器件材料指数收报 932.97 点，环比下跌 5.84%；中信三级行业有机硅材料指数收报 5004.39 点，环比下跌 0.36%；中信三级行业碳纤维指数收报 918.51 点，环比下跌 2.01%；中信三级行业锂电指数收报 1483.68 点，环比下跌 1.36%；Wind 概念可降解塑料指数收报 1367.33 点，环比下跌 2.75%。

图表 1: Wind 概念新材料指数



来源：Wind，华福证券研究所

图表 2: 申万行业半导体材料指数



来源：Wind，华福证券研究所

图表 3: 申万行业显示器件指数



来源：Wind，华福证券研究所

图表 4: 中信行业有机硅指数



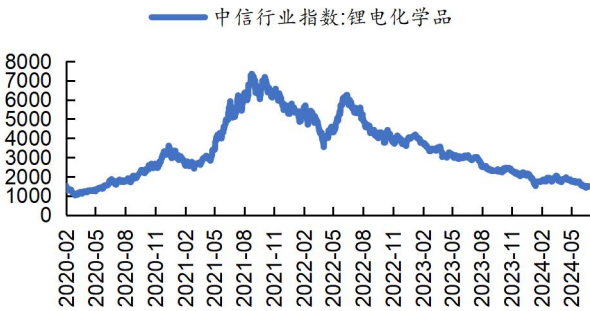
来源: Wind, 华福证券研究所

图表 5: 中信行业碳纤维指数



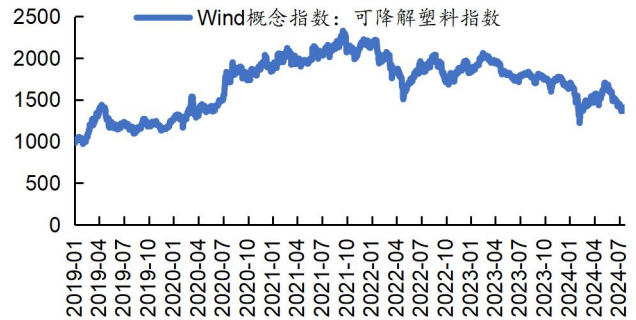
来源: Wind, 华福证券研究所

图表 6: 中信行业锂电化学品指数



来源: Wind, 华福证券研究所

图表 7: Wind 概念可降解塑料指数



来源: Wind, 华福证券研究所

2 重点关注公司周行情回顾

2.1 周涨跌幅前十

本周, 涨幅前十的公司分别为: 国瓷材料(8.22%)、华特气体(7.07%)、安集科技(5.54%)、飞凯材料(4.95%)、光威复材(4.94%)、合盛硅业(4.76%)、江化微(4.05%)、彤程新材(3.96%)、金宏气体(3.54%)、沃特股份(3.47%)。

图表 8: 本周涨跌幅前十

	代码	名称	涨跌幅	市值(亿元)
1	300285	国瓷材料	8.22%	191.73
2	688268	华特气体	7.07%	63.59
3	688019	安集科技	5.54%	158.24
4	300398	飞凯材料	4.95%	67.40
5	300699	光威复材	4.94%	234.94
6	603260	合盛硅业	4.76%	572.54
7	603078	江化微	4.05%	53.49
8	603650	彤程新材	3.96%	185.34
9	688106	金宏气体	3.54%	89.87



10	002886	沃特股份	3.47%	38.51
----	--------	------	-------	-------

数据来源：Wind，华福证券研究所

本周，跌幅前十的公司分别为：新亚强(-10.62%)、三祥新材(-8.33%)、瑞丰高材(-7.53%)、晨光新材(-7.51%)、阿科力(-7.33%)、仙鹤股份(-7.1%)、硅宝科技(-6.78%)、润阳科技(-6.74%)、斯迪克(-6.34%)、奥来德(-6.14%)。

图表 9：本周涨跌幅后十

	代码	名称	涨跌幅	市值(亿元)
1	603155	新亚强	-10.62%	34.83
2	603663	三祥新材	-8.33%	55.64
3	300243	瑞丰高材	-7.53%	20.31
4	605399	晨光新材	-7.51%	34.35
5	603722	阿科力	-7.33%	35.00
6	603733	仙鹤股份	-7.10%	124.68
7	300019	硅宝科技	-6.78%	47.87
8	300920	润阳科技	-6.74%	13.55
9	300806	斯迪克	-6.34%	46.87
10	688378	奥来德	-6.14%	43.27

数据来源：Wind，华福证券研究所

2.2 重要公告

【蓝晓科技】7月15日，公司发布2024年半年度业绩预告。2024年上半年度公司实现收入12.69-13.2亿元，同比增长26-31%；实现归母净利润3.94-4.1亿，同比增长13.94-18.45%。公司积极应对外部不利因素，吸附分离材料销售保持良好增长，国际市场竞争力进一步提升。生命科学、提锂订单持续拓展、超纯水领域产品销售规模增加，持续满足高端应用需求。报告期内，汇兑收益约为404万元；上年同期公司汇兑收益为3761万元；剔除汇兑收益影响，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长约26%-30%。

3 近期行业热点跟踪

3.1 2024年上半年OLED智能手机出货量将同比增长43%

7月18日，Counterpoint Research发文称，2024年第一季度OLED智能手机出货量和营收较2023年同期分别增长了50%和3%。

预计2024年上半年，OLED智能手机出货量将同比增长43%，营收同比增长7%。

预计2024年全年，OLED智能手机出货量将同比增长21%，面板营收同比增长3%。其中柔性OLED出货量同比增长13%，折叠式OLED出货量同比增长



26%，刚性 OLED 出货量同比增长 46%。

报告预计，OLED 智能手机在 2024 年的出货量增长将达到两位数。最新的经济指标显示通胀环境正趋于稳定，并且有迹象表明，人工智能和三星、苹果等公司的新机型将强有力地推动该增长趋势，并形成一個超级周期。

从报告中获悉，DSCC 预计苹果将在 2024 年占据领先地位，出货量份额和智能手机设备营收份额分别为 29% 和 50%，低于 2023 年的 36% 和 52%，这是由于荣耀、华为、OPPO、三星、vivo、小米等品牌的份额增长所致。三星预计将凭借出货量同比增长 49% 来提升其市场份额。（资料来源：OLEDindustry、IT 之家）

3.2 87 亿美元！日本 32 家电子元件制造商投资额将增长 5.4%

随着汽车从混合动力传动系统到高级驾驶辅助系统等各个领域继续采用更多的电气部件，日本的电子元件制造商本财年预计将资本支出提高 5.4%。

根据村田制作所、TDK 和京瓷等 32 家公司的投资计划，预计 2024 财年总支出将达到 1.4 万亿日元（87 亿美元），较 2023 年增长 5.4%，比四年前增长 46%。其中 19 家公司计划增加支出。

电容器、线圈等被动元件是投资的重心，占比达 60%。2024 财年该领域的投资有望达到 8672 亿日元，延续 2023 财年的高水平。尤其是多层陶瓷电容器（MLCC），一般来说，智能手机中大约使用 1000 个 MLCC，燃油车中大约使用 5000 个，电动汽车中大约使用 10000 个。

日本公司主导着这些零部件的全球市场。村田拥有汽车 MLCC 的最大份额，TDK 和太阳诱电也位列前五。随着韩国和中国台湾公司的崛起，日本公司希望通过保持资本投资来维持市场份额。

村田 2024 财年计划投资 1900 亿日元，将汽车用 MLCC 产能提高 10%。

TDK 总裁 Noboru Saito 表示：“电动汽车目前正处于调整阶段，但混合动力汽车和插电式汽车对 MLCC 的使用仍将增加。”该公司预计今年的资本投资将达到 2500 亿日元，比上年增长 14%。TDK 的投资将集中在电池上，其电池占销售额的一半，但约 25% 将分配给 MLCC 等被动元件。

32 家公司对电动汽车和混合动力汽车的电机也进行了大力投资，投资总额达 1576 亿日元，较 2023 财年增长 14%。

投资热潮还延伸到电子电路板。随着汽车电气化程度的提高，对密集排列半导体和零部件的电路板的需求也在增加。2024 财年日本电路板投资将达 2225 亿日元，增长 22%。



除了汽车零部件外，电子元件制造商也在投资人工智能（AI）领域。

太阳诱电今年计划投资 700 亿日元，其中大部分将投资 AI 服务器用 MLCC。该公司每年将产能提高 10%~15%，并将在中国和马来西亚的工厂设立生产线。

京瓷今年计划投入 2000 亿日元资本支出，较上一财年增长 20%，为公司历史上最大单笔资本支出，该公司将投资用于数据中心的 AI 半导体先进封装的生产设施。（资料来源：满天芯）

3.3 Q2 全球智能手机出货量达 2.88 亿部，小米增速居首

市场调查机构 Canalys 最新研究显示，全球智能手机市场连续第三季度同比增长，2024 年第二季度出货量环比增长 12%，达到 2.88 亿部。

其中，三星以 18% 的市场份额继续保持全球领先地位，再次将高端市场作为战略重点；苹果以 16% 的市场份额紧随其后，排名第二；小米以 15% 的市场份额紧随苹果之后，以 27% 的年增长率成为前五大厂商中增速最快的厂商；vivo 以 9% 的市场份额位居全球第四；传音排名第五，市场份额也是 9%。（资料来源：满天芯）

3.4 日系被动元件大厂计划涨价 20%!

7 月 16 日消息，据《经济日报》报道，受益于智能手机及 PC 市场的需求回暖以及传统旺季的即将来临，叠加银价今年以来大涨超 30%，日本被动元器件大厂村田、TDK 等正酝酿调涨产品报价，涨价的产品初步将锁定积层式电感、磁珠等产品，涨幅或达 20%，为近年被动元件业罕见大涨价。

被动元件产业历经一年以上的库存调整期，近期随着库存陆续回到健康水位、客户回补库存，以及迎接传统旺季，推动了相关被动元件的需求。此外，银价的大幅上涨也是推动积层式电感、磁珠等涨价的关键原因。

据了解，银占积层式电感、磁珠成本比重高达六成，由于银价今年来一度大涨近 40%，即便近期略微回调，统计年初以来仍大涨 35%，大举推升制造商量产积层式电感、磁珠的成本压力。

为应对下半年各手机大厂新机齐发，加上 PC 市场逐渐转向复苏，同时面对银价上涨带来的成本压力。一线大厂包括村田、TDK 等，计划调升积层式电感、磁珠报价，预期大尺寸会先涨价，涨幅约 10% 至 20%。

有研究数据显示，数据显示，全球电感产业集中度高，以村田、太阳诱电、TDK 等日系电感器大厂为主，占据全球 40%-50% 的市场份额，这三大日系厂商长期占据电子元器件行业的龙头地位。同时，TDK 和村田也是全球前两大片式铁氧体磁珠（Chip Ferrite Beads）制造商，合计占据 30% 以上的市场份额。



鉴于 TDK 和村田等日系厂商在电感和磁珠市场的领先地位，他们率先对相关产品进行涨价，或将引发其他厂商跟进。

除了日系厂商酝酿涨价之外，台系电感大厂国巨集团旗下的奇力新、华新科技集团旗下的佳邦、台庆科技的相关产品线也有可能涨价。同样，国内的被动原件厂商顺络电子、麦捷电子、风华高科等也有望在此轮涨价当中受益。（资料来源：芯智讯）

3.5 预估 2024 年全球 AI 服务器产值达 1870 亿美元, 约占服务器市场比重 65%

根据全球市场研究机构 TrendForce 集邦咨询最新发布「AI 服务器产业分析报告」指出，2024 年大型 CSPs（云端服务业者）及品牌客户等对于高阶 AI 服务器的高度需求未歇，加上 CoWoS 原厂台积电及 HBM（高带宽内存）原厂如 SK hynix（海力士）、Samsung（三星）及 Micron（美光科技）逐步扩产下，于今年第 2 季后短缺状况大幅缓解，连带使得 NVIDIA（英伟达）主力方案 H100 的交货前置时间（Lead Time）从先前动辄 40-50 周下降至不及 16 周，因此 TrendForce 集邦咨询预估 AI 服务器第 2 季出货量将季增近 20%，全年出货量上修至 167 万台，年增率达 41.5%。

TrendForce 集邦咨询表示，今年大型 CSPs（云端服务供应商）预算持续聚焦于采购 AI 服务器，进而排挤一般型服务器成长力道，相较于 AI 服务器的高成长率，一般型服务器出货量年增率仅有 1.9%。而 AI 服务器占整体服务器出货的比重预估将达 12.2%，较 2023 年提升约 3.4 个百分点。若估算产值，AI 服务器的营收成长贡献程度较一般型服务器明显，预估 2024 年 AI 服务器产值将达 1,870 亿美元，成长率达 69%，产值占整体服务器高达 65%。（资料来源：TrendForce 集邦）

4 相关数据追踪

本周，费城半导体指数收报 5267.16 点，环比下跌 8.8%。

图表 10: 费城半导体指数

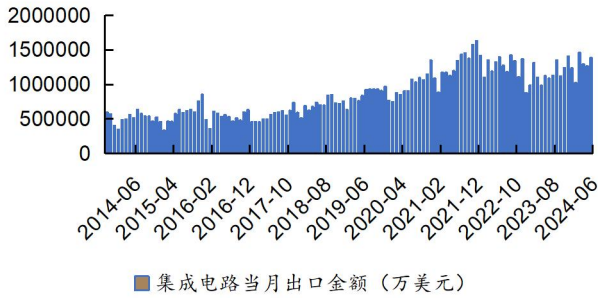


来源：Wind，华福证券研究所



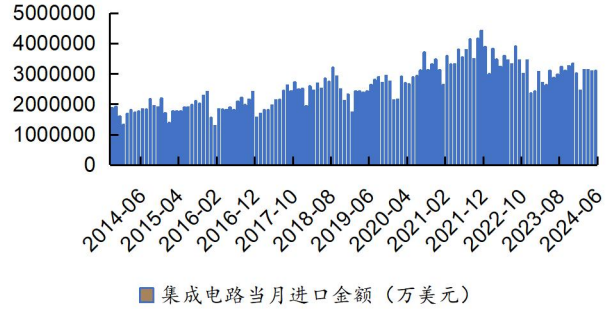
6月，中国集成电路出口金额达到138.62亿美元，同比上涨23.39%，环比上涨9.72%；集成电路进口金额达到310.28亿美元，同比下降0.1%，环比上涨0.33%。

图表 11: 国产集成电路当月出口金额 (万美元)



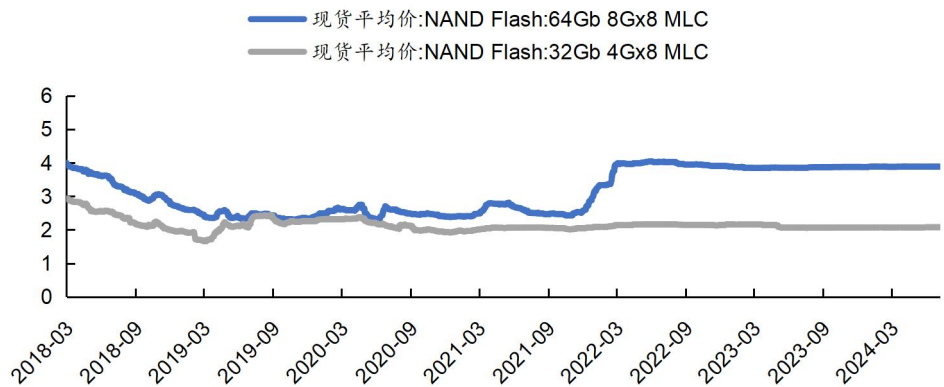
来源: Wind, 华福证券研究所

图表 12: 国产集成电路当月进口金额 (万美元)



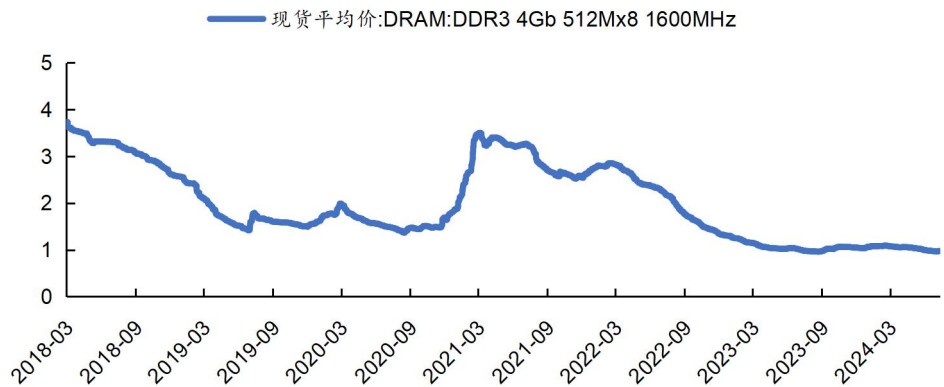
来源: Wind, 华福证券研究所

图表 13: NANDFlash 日度价格图 (美元)



来源: Wind, 华福证券研究所

图表 14: DRAMDDR3 日度价格图 (美元)



来源: Wind, 华福证券研究所



5 风险提示

下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

一般声明

华福证券有限责任公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，该等公开资料的准确性及完整性由其发布者负责，本公司及其研究人员对该等信息不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，之后可能会随情况的变化而调整。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

在任何情况下，本报告所载的信息或所做出的任何建议、意见及推测并不构成所述证券买卖的出价或询价，也不构成对所述金融产品、产品发行或管理人作出任何形式的保证。在任何情况下，本公司仅承诺以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告以供投资者参考，但不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的承诺或担保。投资者应自行决策，自担投资风险。

本报告版权归“华福证券有限责任公司”所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	评级	评级说明
公司评级	买入	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅在 20%以上
	持有	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于 10%与 20%之间
	中性	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于-10%与 10%之间
	回避	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于-20%与-10%之间
	卖出	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅在-20%以下
行业评级	强于大市	未来 6 个月内，行业整体回报高于市场基准指数 5%以上
	跟随大市	未来 6 个月内，行业整体回报介于市场基准指数-5%与 5%之间
	弱于大市	未来 6 个月内，行业整体回报低于市场基准指数-5%以下

备注：评级标准为报告发布日后的 6~12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准；香港市场以恒生指数为基准，美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准（另有说明的除外）

联系方式

华福证券研究所 上海

公司地址：上海市浦东新区浦明路 1436 号陆家嘴滨江中心 MT 座 20 层

邮编：200120

邮箱：hfjys@hfzq.com.cn